

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成29年6月29日(2017.6.29)

【公開番号】特開2016-215336(P2016-215336A)

【公開日】平成28年12月22日(2016.12.22)

【年通号数】公開・登録公報2016-069

【出願番号】特願2015-104552(P2015-104552)

【国際特許分類】

B 24 B 57/02 (2006.01)

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/00 (2012.01)

【F I】

B 24 B 57/02

H 01 L 21/304 6 2 2 E

B 24 B 37/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成29年5月12日(2017.5.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

仕上げ研磨を行う最終研磨工程の前に予備的な研磨を行う予備研磨工程において使用される研磨方法であり、水溶性高分子を含有する研磨用組成物を使用して研磨対象物を研磨する研磨方法であって、

タンク内の前記研磨用組成物を前記研磨対象物に供給しながら前記研磨対象物を研磨する研磨工程と、

前記研磨対象物の研磨に使用された前記研磨用組成物を回収して前記タンクに戻し循環させる回収工程と、

前記研磨対象物に供給される前記研磨用組成物中の前記水溶性高分子の濃度を、予め設定された範囲内の数値となるように調整する組成調整工程と、

を備え、

前記組成調整工程は、前記研磨用組成物の供給によって前記研磨対象物に供給される前記水溶性高分子の量が、前記研磨対象物の表面  $1 \text{ mm}^2$  当たり  $0.0004 \text{ mg} / \text{min}$  以上  $0.0030 \text{ mg} / \text{min}$  以下となるように、前記研磨対象物に供給される前記研磨用組成物に、水溶性高分子を含有する組成調整剤を添加する工程である研磨方法。

【請求項2】

前記研磨対象物がシリコンウェーハである請求項1に記載の研磨方法。

【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載の研磨方法において使用される組成調整剤であって、水溶性高分子を含有する組成調整剤。

【請求項4】

前記水溶性高分子が、セルロース誘導体、デンプン誘導体、オキシアルキレン単位を含有するポリマー、窒素原子を含有するポリマー、及びビニルアルコール系ポリマーのうちの少なくとも1種である請求項3に記載の組成調整剤。